

'지능형반도체 개발·실증 지원' 사업 시제품제작지원 수요기업 모집공고('24년 1차)

한국팹리스산업협회에서는 산업통상자원부가 지원하는 '지능형반도체 개발·실증 지원' 사업의 일환으로, 국내 지능형반도체 기업의 경쟁력 강화를 위한 「시제품제작 지원」 프로그램을 다음과 같이 공고하오니, 관심있는 기업의 많은 참여를 부탁드립니다.

2024년 08월 28일

한국팹리스산업협회장

1. 사업 개요

가. 사업목적

- 지능형 반도체 시제품 제작 비용 지원을 통해 신기술·신제품 개발을 위한 생산애로 해소 및 글로벌 경쟁력 확보

나. 사업내용

- 지원대상
 - 비수도권(서울·경기·해외 제외) 소재의 지능형반도체 설계 기업(팹리스, IP 전문 기업 등)으로 중소기업 및 중견기업(창업 및 벤처기업 포함)
- 지원규모

구분	시제품제작지원프로그램
'24년 공고예산	기업당 40백만원 이내
선정 규모	2개 기업 내외

다. 공고기간

- 공고 및 접수기간
 - 2024년 08월 28일(수) ~ 2024년 09월 11일(수) 15:00까지(15일간)

2. 지원내용

가. 지원범위

- 시제품 제작에 관련된 비용(디자인하우스 비용, MPW·FPGA 제작 등)

나. 지원내용

품목	지원내용
디자인하우스 비용	칩설계코드를 바탕으로 MPW제작을 위한 마스크 제작 및 테스트 비용 등 디자인 하우스 비용
MPW 제작	MPW shuttle Service를 제공하는 국내·해외 파운드리 기업의 모든 공정 비용 (일반, 미세, 초미세 상관없음)
FPGA 제작	칩설계코드를 바탕으로 FPGA 제작을 위한 비용 중 IP 및 보드 등 제작 비용(인건비 제외)

3. 지원자격 및 우대사항

가. 지원자격

- 중소기업기본법 제2조 및 중소기업시행령 제3조(중소기업의 범위)에 해당하는 중소기업
- 중견기업성장촉진 및 경쟁력강화에 관한 특별법 제2조 해당하는 중견기업
- 신청기업이 설계한 제품으로, 2024년 8월~12월 내 시제품 제작이 가능한 기업
- 본 지원프로그램의 목적 및 취지에 부합하는 국내 지능형반도체 기업

나. 우대사항

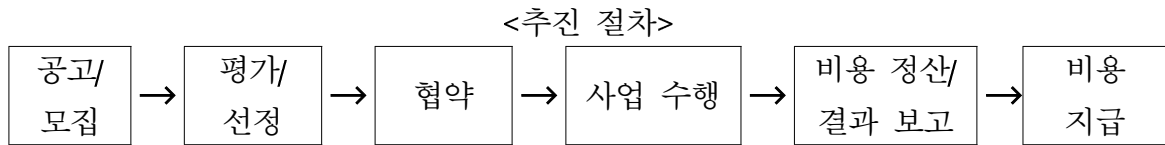
- 지능형반도체개발지원센터(가칭) 입주(예정)기업

우대사항	순위
지역 우대	1) 지능형반도체개발지원센터(가칭) 입주 및 입주 예정 기업* * 지능형반도체개발지원센터(가칭) 입주계약서 및 입주확약서 제출 기업 (~ ' 25년까지 입주에 한함)

4. 추진절차 및 평가기준

가. 추진절차 및 일정

○ 추진절차



○ 주요일정

내용	일정	방법	비고
공고 및 접수	8.28~9.11	이메일 접수	신청서(양식) 작성하여 제출
선정평가	9월 4주	서류검토 및 발표평가	발표 평가 방법은 개별 안내
협약체결 (센터-기업)	10월 초	협약서	선정 완료 후 2주일 이내
결과보고	11월 말	결과보고서 제출	(필요시)사전 결과보고서 제출
사업비 신청	12월 내	사업비 신청	결과보고서 제출 후 15일 이내

나. 평가기준

평가 항목 (기준)	제품 우수성 (30)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개발제품의 기술성 (명확한 아이템, 기존 제품과의 차별성) ○ 설계 결과물의 우수성/완성도
	시장성 (30)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개발제품의 시장성 (목표하는 시장이 구체적이고 명확함) ○ 비즈니스 모델/사업추진 계획 ○ 개발제품의 가치 및 파급효과
	기업상태 (15)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기업의 성장가능성(창업여부, 기업의 기술력, 경쟁력 등) ○ 기업의 재무건정성(매출 및 부채 등 경영상황)
	적절성 (15)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공정 및 원가 등 비용의 적절성
	우대사항 (5)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지능형반도체개발지원센터(가칭) 입주기업 혹은 입주협약서 제출 기업*(5점)

5. 신청방법 및 제출안내

가. 제출서류

번호	서류명	부수	제출	비고	형태	접수방법
1	지원신청서(원본) ※관련견적서 포함(별첨 참고)	1부	필수	지정서식	전자파일 (HWP)	이메일
2	지원신청서(날인본)	1부	필수		전자파일 (PDF)	
3	최근 2개년도 기업 재무제표	1부	필수	2022-2023년	스캔본 (PDF)	
4	사업자등록증 사본 (지사, 연구소 별도 제출)	1부	필수	-		
5	국세·지방세 완납증명서	1부	필수			
6	법인인감증명서	1부	필수			
7	지능형반도체개발지원센터 (가칭) 입주계약서 (혹은 입주확약서)	1부	선택	우대사항		

○ 서류제출 시 유의사항

- 신청서의 성실한 작성도 평가항목이므로 예시 및 작성요령에서 제시한 사항 (파란글씨)을 참고하여 성의있게 작성
- 제출서류가 위·변조 혹은 허위임이 밝혀질 경우 그 즉시 선정 취소 또는 협약이 해약되므로 사실대로 작성하여 제출할 것
- ‘기타 추가 증빙서류’ (8번)는 본 과제와 관련하여 추가로 제출하고자 하는 서류가 있을 경우만 제출(ex. 사업장 이전 확인서, 관련 특허증, 수상이력 등)
- 서류제출 시 파일명에 순번과 서류명, 신청기업명 기입
(ex. 3_사업자등록증 ((주)침정원).pdf)

나. 신청방법

- 한국팹리스산업협회 홈페이지(www.k-fabless.com)에서 공고문 확인
- 공고문 내 첨부 신청서 양식을 다운로드하여 작성 후 이메일 제출
- 접수방법 : 제출서류를 모두 구비하여 이메일 (kfia.khj@gmail.com) 제출
- * 마감일 15시 이전 도착분에 한하며, 제출 후 필히 ‘접수 확인 메일’ 확인
(접수 후 1시간 이내 확인 메일 미수신시 미접수 상태이므로 접수 여부 유선 문의)

6. 과제신청 유의사항

가. 지원제외 처리기준

- 타 정부과제 중복지원 불가(동일 건으로 중복지원 불가)
- 신청기업이 지원사업의 목표, 취지에 부합하지 않는 경우(외국계기업의 국내법인 등)
- 접수마감일 현재 신청기업이 국가연구개발사업에 참여제한을 받고 있는 경우
- 접수마감일 현재 신청기업이 아래의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 기업의 부도
 - 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우(단, 회생인가 받은 기업, 중소벤처기업진흥공단 등으로부터 재창업자금을 지원받은 기업은 예외)
 - 최근 결산 기준 자본전액잠식
- 접수기간 내에 사업계획서 등의 서류 제출이 미비한 경우

7. 문의처

- 한국팹리스산업협회 (연락처 : 031-8017-8777, kfia.khj@gmail.com)
 - 주소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 27, 203호(금토동)